

Elephantech

AgIC FPC P-Flex® 実装サービス開始のお知らせ

2017年7月31日

プリントド・エレクトロニクス技術を開発するAgIC株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役：清水信哉、以下AgIC）は、ピュアアディティブ®法で製造されたフレキシブル基板「P-Flex®」の実装サービスを開始しました。

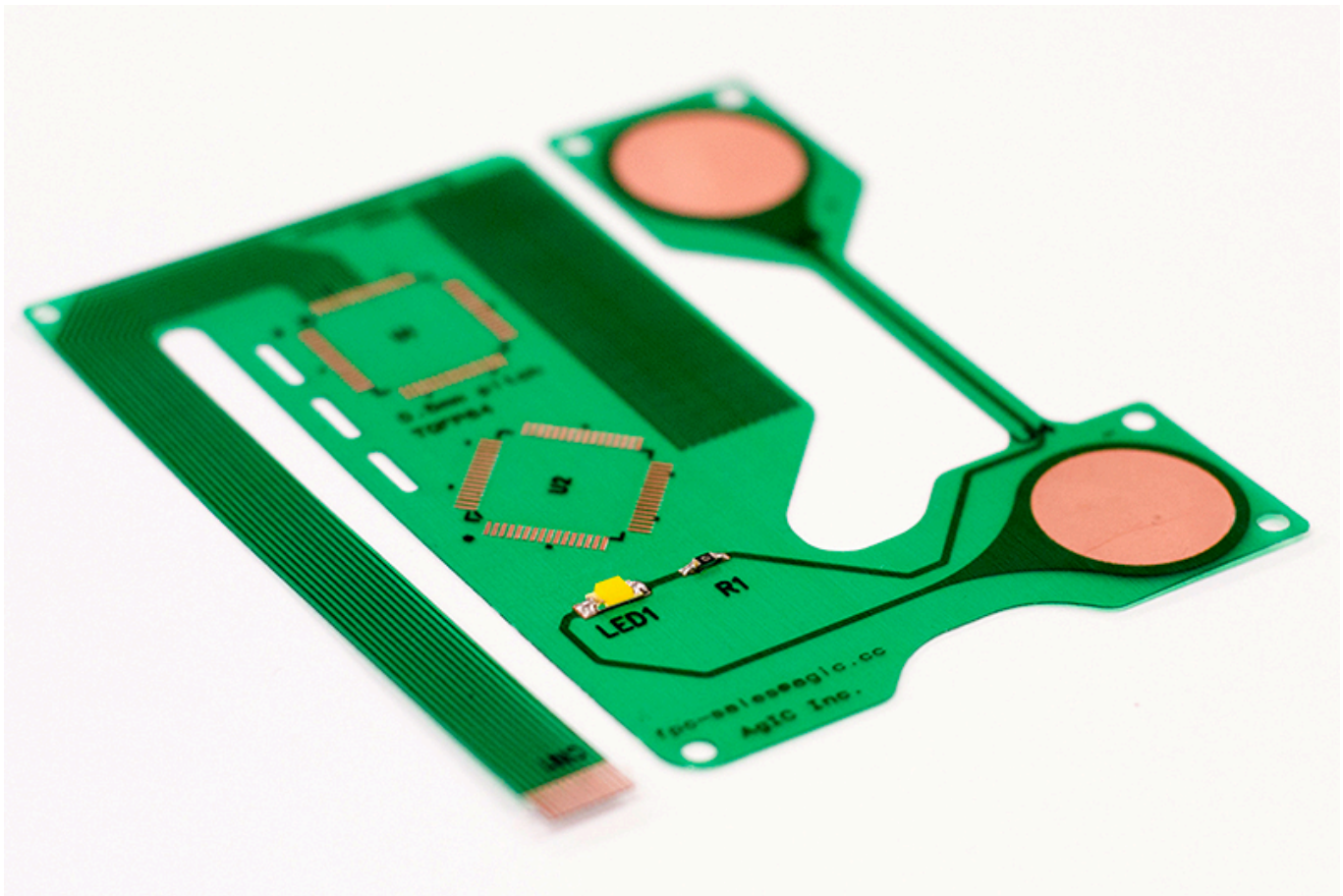
部品実装P-Flex®の特長

P-Flex®はICチップ、LED、抵抗、コネクタなどの部品を実装したモジュールとしてもご利用頂けます。例えば温度センサーを実装し、温度センシングモジュールとしてご利用頂いているケースなど、部品実装P-Flexは各種メーカー様でご利用頂いております。

ただし、P-Flex®はPETベースであるため、ポリイミドベースのFPCに比べると耐熱性に劣り、部品実装プロセスにも特有の低温はんだ、温度プロファイルが必要になります。

[🔗 低温はんだについての詳細記事はこちら](#)

弊社では、P-Flex®に部品を実装し、実装済み基板として完成した状態でのお届けを行っております。



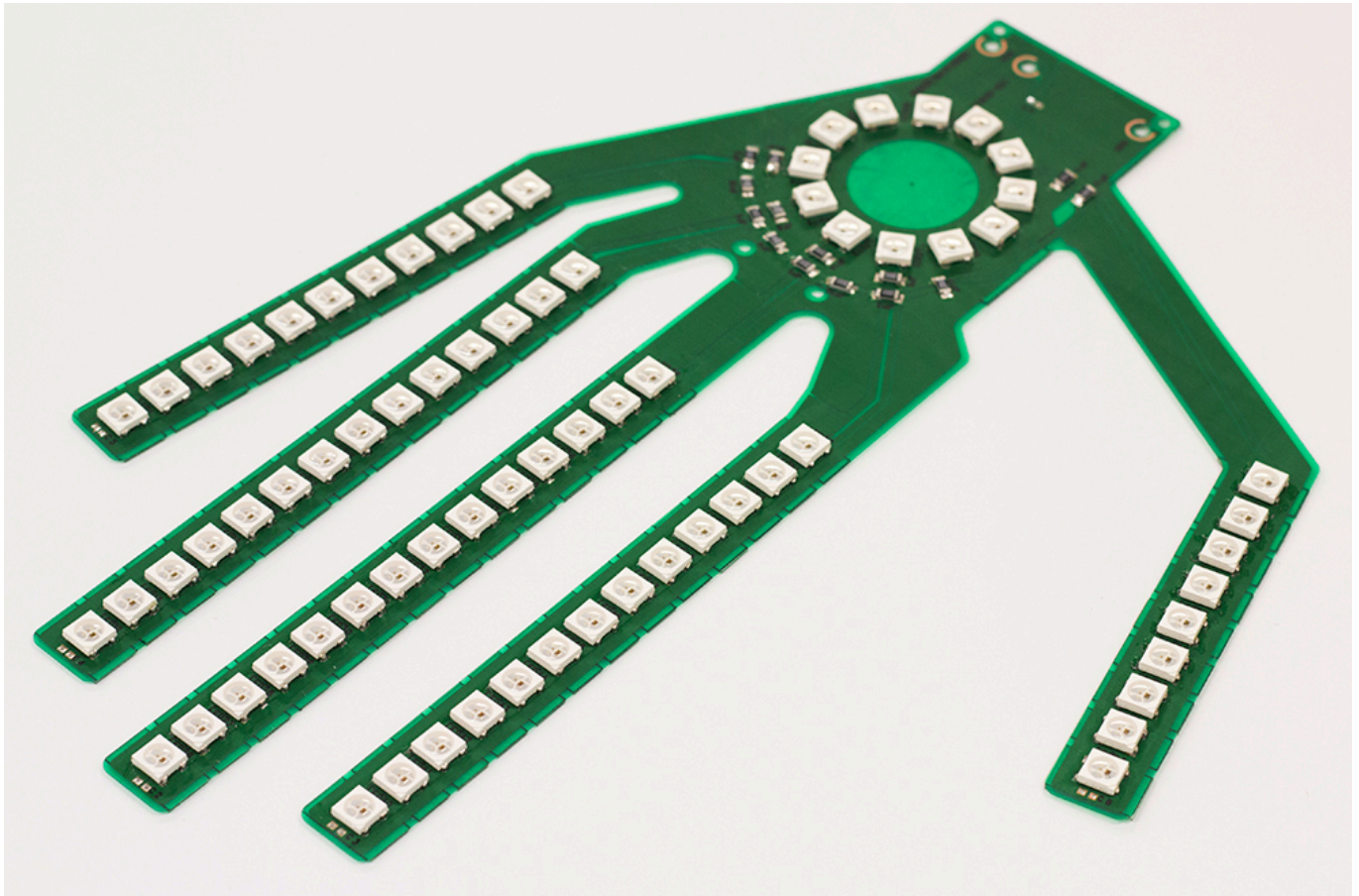
P-Flex®

標準対応範囲

- ・チップ部品実装（最小1005サイズ）
- ・QFP, QFNパッケージ実装（最小0.5mmピッチ）
- ・コネクタ実装（最小0.5mmピッチ）
- ・補強板貼り付け
- ・コネクタ部へのNi-Auめっき仕上げ

※ 上記以外の狭ピッチ部品、上記に含まれない追加工などは別途ご相談下さい

製造例

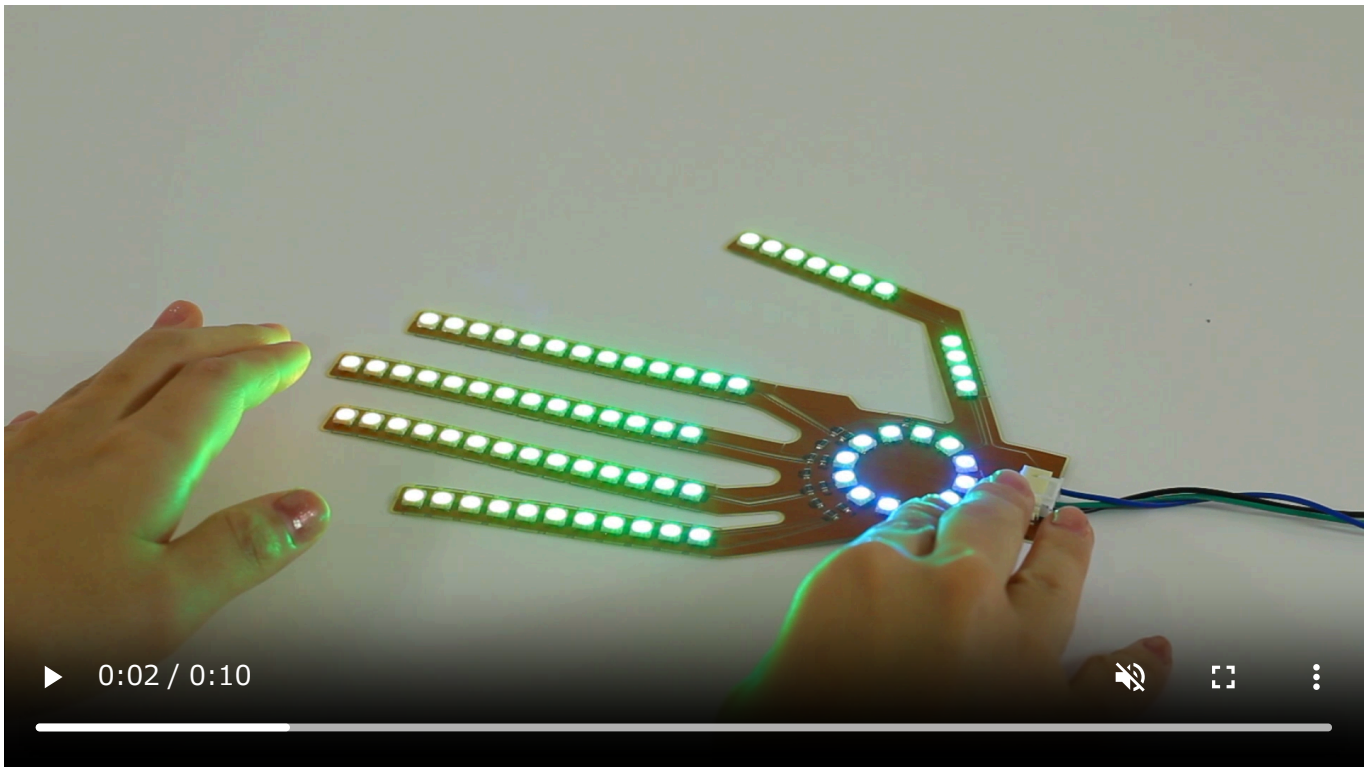


(GROOVE様)

3216ジャンパー 0オーム抵抗 14pcs

SK6812 5050RGG LED 73pcs

裏板 0.5mm



画像の基板は以前のバージョンです。

(参考ページ)

 [部品実装P-Flex®](#)

会社概要

| | |
|------|-----------------------------------------------|
| 名称 | AgIC 株式会社 |
| 代表 | 代表取締役 清水信哉 |
| 設立 | 2014年1月 |
| 資本金 | 2億4070万円（資本準備金を含む） |
| 所在地 | 東京都文京区本郷 5-25-18, ハイテク本郷ビル 1F |
| URL | http://agic.cc/ |
| 事業内容 | プリントド・エレクトロニクス製造技術の開発、サービス提供 |

2017年7月31日現在

本件に関するお問い合わせ先

<https://www.elephantech.co.jp/products/pflex/mounting/>

AgIC株式会社 P-Flex® 担当窓口

メールアドレス : fpc-sales@elephantech.co.jp